भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 770

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।

15 माघ, 1947 (शक)

डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का दूसरा चरण

770. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. क्या सरकार को सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई 2.0) योजना के दूसरे चरण की संरचना के संबंध में नीति निर्माताओं और उद्योग के बीच मतभेदों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ख. क्या इस बात का कोई आकलन किया गया है कि डीएलआई 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित समान वित्तपोषण मॉडल महाराष्ट्र में स्टार्ट-अप और चिप डिजाइन कंपनियों को किस प्रकार प्रभावित करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ग. क्या इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि समतुल्य निजी पूंजी की आवश्यकता से महाराष्ट्र में छोटी फर्मों और प्रारंभिक चरण के नवोन्मेषकों को नुकसान हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

घ. क्या सरकार का महाराष्ट्र में सेमीकंडेक्टर डिजाइन कंपनियों के लिए डीएलआई 2.0 प्रोत्साहनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई संशोधन करने या सुरक्षा उपाय लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

ङ. क्या राज्य की सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकास योजनाओं के साथ डीएलआई ढांचे को संरेखित करने के लिए उद्योग के हितधारकों और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** भारत सरकार की सेमीकंडक्टर रणनीति प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण पर आधारित है। यह तैयार उत्पाद असेंबली, उप-असेंबली, घटकों, चिप डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग आदि से विनिर्माण विकसित करने के लिए एक सुविचारित रणनीति है।

भारत की सेमीकंडक्टर डिजाइन रणनीति देश के डीप टैलेंट पूल, वैश्विक डिजाइन नेतृत्व और बढ़ते स्टार्टअप आधार का लाभ उठाकर एक मजबूत, आत्मनिर्भर चिप डिजाइन इकोसिस्टम के निर्माण पर केंद्रित है।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण को विकसित करने और सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स घटक के निर्माण के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम को और व्यापक बनाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2022 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना इस कार्यक्रम का हिस्सा है। योजना की सफलता को नीचे दिए गए प्रदर्शन से देखा जा सकता है:

- 900 करोड़ रुपये के कुल परियोजना मूल्य के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स और एसओसी के डिजाइन के लिए 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें डिजाइन बुनियादी ढांचे में निवेश भी शामिल है। ये परियोजनाएं वीडियो निगरानी, ड्रोन का पता लगाने, ऊर्जा मीटरिंग, माइक्रोप्रोसेसर, उपग्रह संचार और ब्रॉडबैंड और आईओटी एसओसी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं।
- 100 फैबलेस चिप डिजाइन कंपनियों को उन्नत चिप डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच के साथ समर्थन दिया गया है, जो संचयी रूप से 55 लाख घंटे के उपकरण उपयोग की खपत करते हैं।
- कई फाउंड्री में टेप किए गए 16 डिज़ाइनों में से 7 चिप्स को सफलतापूर्वक बनाया गया है, जिसमें टीएसएमसी में 12 एनएम जैसे उन्नत नोड्स शामिल हैं।
- 10 पेटेंट दायर किए गए हैं, और 140+ पुन: प्रयोज्य अर्धचालक आईपी कोर विकसित किए गए हैं, जो उन्नत चिप डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण सक्षमकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं।
- 13 कंपनियों ने अपने समाधानों को बढ़ाने और उत्पाद बनाने के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग जुटाई है, जिससे निजी निवेश को 3× से अधिक प्रोत्साहनों पर गति दी गई है।

चिप्स टू स्टार्टअप (सी2एस) पहल का **उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को स्वदेशी चिप्स डिजाइन और विकसित करने में सक्षम बनाकर सेमीकंडक्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम का पोषण करना है।** पहल की सफलता को नीचे दिए गए प्रदर्शन से देखा जा सकता है:

- 315 शैक्षणिक संस्थानों को उन्नत ईडीए उपकरण प्रदान किए गए और 100 शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की गईं।
- उद्योग भागीदारों के साथ 300 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए
- चिप डिजाइन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित लगभग 67,000 छात्रों के साथ 1 लाख से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों ने प्रशिक्षण में दाखिला लिया है।
- छात्रों द्वारा 1.6 करोड़ घंटे के ईडीए उपकरणों का उपयोग - केंद्रीकृत चिप डिजाइन सुविधा का दुनिया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आधार।
- पूरे भारत में 46 संस्थानों ने एससीएल फाउंड्री में निर्माण के लिए 122 चिप डिजाइन प्रस्तुत किए। इनमें से 56 छात्रों द्वारा डिज़ाइन किए गए चिप्स को सफलतापूर्वक निर्मित, पैक किया गया और संस्थानों को वापस वितरित किया गया।
- इन संस्थानों द्वारा 75 से अधिक पेटेंट दायर किए गए हैं और 100+ चिप्स का विकास प्रगति पर है।

सरकार सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सेमीकॉन 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की गई है।

*****